



일시

2025년 4월 24일 금요일

장소

여의도 한국경제인협회(구,전경련회관) FKI타워 컨퍼런스센터 3층 다이아몬드홀

주최

화학경제연구원

프로그램

Time	Contents	Speaker
Theme A. 첨단 반도체 산업 전망 및 반도체 소재 기술 동향 [전공정]		
09:50 - 10:30	한국형 차세대 AI 반도체 개발 동향 및 AI 반도체 산업 전망 - AI 반도체 개발 동향 및 기술 동향 - AI 반도체 산업 전망 및 향후 국내 반도체 산업의 혁신과 방향	모빌린트 신동주 대표이사
10:40 - 11:20	Automotive·피지컬 AI 반도체의 진화와 반도체 산업 전략 - Automotive 및 Physical AI 반도체 시장 동향과 전망 - Automotive 및 Physical AI 반도체 설계·개발 기술 개요 - Automotive 및 Physical AI 분야 최신 기술 트렌드	보스반도체 박재홍 대표이사 [전 삼성전자 파운드리 부사장]
11:30 - 12:10	차세대 반도체 소재 질화갈륨 에피웨이퍼(GaN Epiwafer) 개발 동향 및 활용 전망 - 질화갈륨(GaN) 반도체 시장 현황 및 질화갈륨(GaN) 반도체 Value Chain 분석 - 최근 질화갈륨(GaN) 반도체 기술관련 이슈 사항 - 국내 질화갈륨(GaN) 반도체 생태계 현황과 향후 기술 전망	아이브이웍스 노영균 대표이사
12:20 - 13:00	반도체 증착용 초고순도 특수가스 기술동향 및 전망 - 반도체용 초고순도 특수가스 및 증착용 특수가스 기술 동향 및 응용 (화학 기상 증착(CVD) 및 원자층 증착(ALD)용 등) - 차세대 반도체용 특수가스 개발 전망 및 활용 전망	에어리퀴드 솔루션즈코리아 김오현 대표이사
Lunch Hour [13:00 - 14:00]		
Theme B. 고성능 반도체 패키징 소재 최신 기술 동향 [후공정]		
14:00 - 14:40	AP 패키징 방열 이슈/성능 개선을 위한 PBA Level의 차세대 방열 소재 개발 동향과 전망 - AP PKG용 방열 언더필/EMC 소재 개발동향 및 활용 사례 - 3D 형상을 가진 TIM (Thermal Interface Material) 기술 - 방열 & EMI Shielding 동시 구현 가능한 복합체 개발과 적용 전망	삼성전자 박민 수석연구원
14:50 - 15:30	반도체 패키징용 실리콘 방열 소재 개발동향 및 활용 전망 - 방열 소재 시장현황 및 전망 - 반도체 패키징 발전 현황 - 반도체 패키징용 방열 소재들의 특성 및 개발 방향 - 반도체 패키징 supply chain	바커케미칼 전자재료연구소 주영혁 팀장
15:40 - 16:20	반도체 패키징용 에폭시 개발 동향 및 소재 활용 전망 - 반도체용 패키징 분야(CCL & EMC) 소재 기술 개발 현황 및 응용/특징 - 반도체용 패키징 분야(CCL & EMC) 소재 경쟁력과 용도별 활용 전망	국도화학 유기환 팀장
16:30 - 17:10	반도체용 CMP패드 기술 동향 및 신기술 적용 사례 연구 - CMP 공정 소개 - CMP 기술 및 Pad 기술 동향 - 신규 CMP pad를 이용한 공정 한계 극복 사례 연구	큐니티 일렉트로닉스 (전 듀폰 전자사업부문) 구자응 상무

* 프로그램 주제 및 일정은 미확정된 내용으로 참고만 부탁드립니다.

등록 안내

참가비

구분	신청시기	금액	그룹 할인
사전등록	3/28 - 4/22 (18시 마감)	39만원(VAT별도)	· 3인 이상 신청 시 전체금액의 10% 할인 * 홈페이지 일괄신청 시 할인적용 가능 (개별신청 시 할인적용 불가)
현장등록	4/23 - 4/24 * 선착순 마감될 경우 현장등록 불가	42만원(VAT별도)	

- 세금계산서는 참가신청 당일 발행되며, 참가비는 5영업일 내 입금을 원칙이며, 입금일이 지연될 경우 문의바랍니다.
- 카드결제 오류시 문의(02-6124-6660)주시면 수기결제 가능합니다.
- 참석자 변경은 4/22까지 가능합니다.

신청방법

- 인터넷신청(<https://www.cmri.co.kr/>) → 무료회원 가입 → 로그인 → 프로그램 선택 → 신청하기 → 온라인결제 → 접수완료

취소 및 환불 규정

- 세미나 10일 전까지(~ 4/14 18:00) 100% 전액 환불 가능하며, 9일 전부터는 환불되지 않습니다.
- 카드 취소시 카드사 사정에 따라 처리가 2-3일 정도 소요될 수 있으며, 무통장입금의 경우 취소신청 후 다음 주 월요일에 입금될 예정입니다.

문의

- 세미나 관련 문의: 컨설팅사업부 (02-6124-6660~8 ext. 503,504 seminar@chemlocus.com)
- 세금계산서(무통장입금), 거래명세서 관련 문의: 총무팀 (02-6124-6660~8 ext. 202, chemj@chemlocus.com)

기타

- 제한된 좌석으로 조기 접수마감 될 수 있습니다.
- 일반등록 기간 내라 하더라도 현장결제를 선택한 경우 현장등록 참가비가 적용됩니다.
- 현장결제 선택 후 사전고지 없이 불참하는 경우, 향후 화학경제연구원이 제공하는 서비스 이용에 불이익이 있을 수 있습니다.
- 참가자에게는 책자형 자료집, 전자형 자료집(PDF), 점심식사가 제공됩니다.
- 주차권은 데스크에서 종일권 발급가능합니다.
- 사전 등록자라 하더라도 행사 시작 1시간 이후 도착 시 좌석 이용에 불편함이 있을 수 있습니다.

장소 안내

· 서울특별시 영등포구 여의대로 24 한국경제인협회(구,전경련회관) 컨퍼런스센터

[전경련회관 교통 안내 페이지 >](#)

